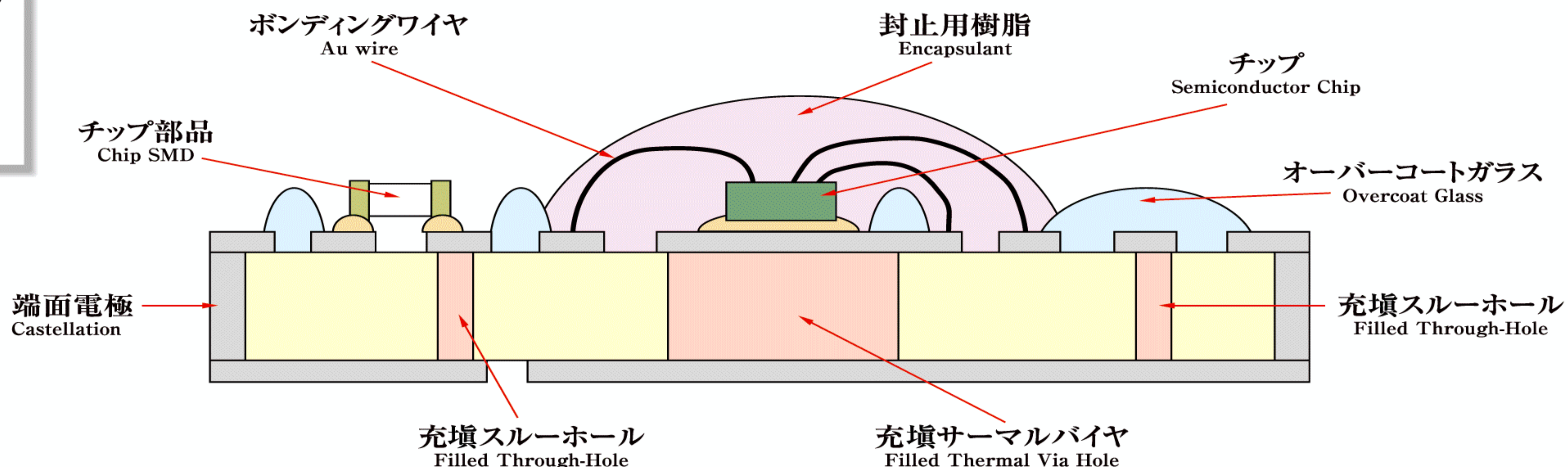


充填サーマルバイア (充填スルーホール) 印刷基板

Thick Film Material Filled Thermal Via (Thick Film Material Filled Through-Hole) Printed substrate.

断面構造 (実装例) Cross Sectional (Assembled)



特長 Features

- 1 サーマルバイア上にパワーICをベアチップ実装し高い放熱効果が得られます。
1 Bare Chip Power ICs can be placed on thermal vias with excellent heat radiation effect.
- 2 サーマルバイア上に部品実装パッドを形成し、高密度実装が可能になります。
2 Parts pads can be accommodated on thermal vias.
- 3 充填スルーホールの上に配線が可能となり、高密度配線が可能になります。
3 Conductor lines can be designed on Ag-filled through-holes.
- 4 全面クロスガラス印刷により、高密度多層基板が可能となります。
4 High density multi-layered substrate can be available with dielectric printing.

仕様 Specification

項目 Parameter		仕様 Specification
材料 Material	基板 Substrate	A l ₂ O ₃ 96%
	サーマルバイア Thermal Via	厚さ Thickness 0.5 0.635 0.8mm
パターン寸法 Patterning	サイズ Size	Ag-Pd
	ピッチ Pitch	0.2mmφ~0.5mmφ 0.2mm□~0.5mm□ min. (孔径+板厚) min. (Hole Dia+Thickness)

端面電極 構造 Castellation

項目 Parameter		仕様 Specification
材料 Material	基板 Substrate	A l ₂ O ₃ 96%
	ペースト Paste	厚さ Thickness 0.5 0.635 0.8mm
パターン形状 Patterning	サイズ Size	丸穴 Circle : φ0.4~0.8mm
		長穴 Oval : 幅0.4~0.6×長2.0mm max.